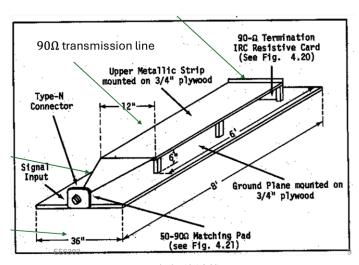
平行板传输线/TEM小室/GTEM小室

平行板传输线



平行板传输线

平行板传输线中电磁波传播的模式是TEM波,与远场中电磁波的传输模式相同。

通常Stripline地层最小是信号层的3倍宽,在末端会用与特性阻抗相同大小的电阻连接以消除反射(传输线阻抗匹配)。

在锥形部分,信号层的宽度和高度始终维持 $\frac{w}{h}=2$ 的关系。

平行板传输线相关公式

传输线单位长度的电容和电感:

$$C_{l}=rac{\epsilon_{r}\epsilon_{0}w}{h}\left(F/m
ight)$$

$$L_l = rac{\mu_r \mu_0 h}{w} \left(H/m
ight)$$

(空气近似于自由空间, $\epsilon \approx 1$)

相速度

$$v_p = rac{1}{\sqrt{C_l L_l}} = rac{1}{\sqrt{\epsilon_r \epsilon_0 \mu_r \mu_0}}$$

特征阻抗

对于平行板传输线:



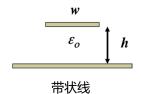
平行板传输线

$$\eta = \sqrt{rac{\mu_r \mu_0}{\epsilon_r \epsilon_0}}$$

自由空间下的特征阻抗(空气或者真空):

$$Z_{0}=\eta_{0}rac{h}{w}\left(\Omega
ight)$$

对于带状线 (我怎么觉得这玩意应该叫microstrip微带线呢):



$$Z_0pprox rac{\eta_0}{rac{w}{h}+2}$$

如果其中的电介质是不色散的,那么传输线的特征阻抗和频率无关。

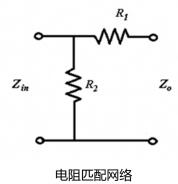
插入损耗

插入损耗可以用匹配网络前后的电压值计算。

$$ext{Insertion Loss} = 20 log rac{V_1}{V_2}$$

如果使用电阻分压网络,只需要计算前后电阻的分压值即可获得插入损耗。 (其实就是前后功率的损耗)

电阻匹配网络的电阻计算



针对这种类型的电阻匹配网络, 只需要保证

$$egin{cases} Z_{in} = R_2 || \left(R_1 + Z_0
ight) \ Z_0 = R1 + Z_{in} || R_2 \end{cases}$$

解这个二元方程组就能够得到 R_1 、 R_2 的值。

如果引入一个辅助值

$$Z'=1-rac{Z_{in}}{Z_0}$$

那么可以计算得到

$$egin{cases} R_1 = Z_0 \sqrt{Z_\prime} \ R_2 = rac{Z_{in}}{\sqrt{Z_\prime}} \end{cases}$$

平行板传输线的优势与劣势

优势

架设容易

成本低

没有频率限制

劣势

自身的电场容易被周围的物体或者电磁传输干扰

如果产生高电场可能会对周围的设备产生干扰

Example 1

这个传输线底层宽 3.75m

按照那个3倍的经验公式,可以算出来顶层宽 1.25m

题干中 h=0.5m ,可以计算得到

$$Z_0 pprox rac{\eta_0}{rac{w}{h}+2} = rac{120\pi}{rac{1.25}{0.5}+2} = 83.776\Omega$$

Example 2

设计匹配网络用前面提到的公式:

$$egin{cases} R_1 = Z_0 \sqrt{Z_{\prime}} \ R_2 = rac{Z_{in}}{\sqrt{Z_{\prime}}} \ Z' = 1 - rac{Z_{in}}{Z_0} \end{cases}$$

直接带进去得到: Z'=0.40317 、 $R_1=53.19\Omega$ 、 $R_2=78.746$

(从这里可以看出老印的计算精度确实让人比较恼火, 难怪open ending)

Example 3

欧姆定律 $P=\frac{U^2}{R}$ 直接出 $V_{in}=35.36\mathrm{V}$. 这边功放输出是 $25\mathrm{W}$ 而不是 $50\mathrm{W}$,不能搞错。

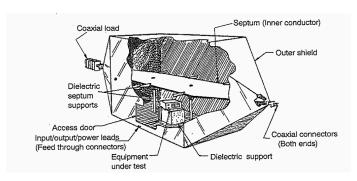
然后用分压就能算出来后续的电压为 $V_s=21.6V$

(需要注意的是从功率算出来的电压值为交流电的均方根值,并不是正弦波的峰值)

然后就是场强计算 $E=rac{V_s}{h}=43.2 {
m V/m}$

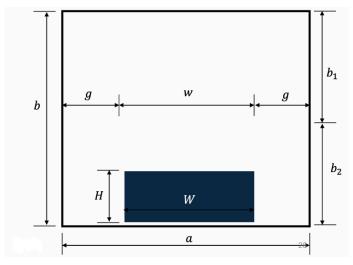
TEM CELL (TEM小室)

这玩意长得像个放大版的同轴线,然后把待测物体放到这个同轴线里面。内部是个平行板,外部被屏蔽壳包裹,平行板与外壳用介电系数尽可能接近于1的电介质隔开。电磁波传播模式也是TEM模。



TEM CELL

TEM CELL相关公式



TEM CELL的横截面

特征阻抗

$$Z_0pproxrac{30\pi}{rac{a}{b}-rac{2}{\pi}ln\left[sinh\left(rac{\pi g}{b}
ight)
ight]}$$

其中 $sinh\left(x
ight)=rac{1}{2}(e^{x}-e^{-x})$

(推过了,这个式子是对的)

最大工作频率

当TEM CELL中电磁波的模式变为 TE_{10} 模时,此时的频率是其最高工作频率。它在设计上是用来传输 TEM 模的,如果变成 TE_{10} 模就不符合设计要求了,所以是最高工作频率。

$$f_c = rac{150}{a} \sqrt{1 + rac{ab}{\pi b_1 b_2 ln\left(rac{4a}{\pi g}
ight)}}$$

如果用当中隔板的相对位置表示,可以代入

$$\left\{egin{array}{ll} b_1=xb \ b_2=\left(1-x
ight)b \end{array}
ight.$$

得到

$$f_c = rac{150}{a}\sqrt{1 + rac{a/b}{\pi x \left(1 - x
ight) ln\left(rac{4a}{\pi g}
ight)}} \left(ext{MHz}
ight)$$

TEM CELL的设计方法

感觉很拍脑袋的做法。

需要满足的基础条件:

$$b_2 \geq rac{3H}{2}$$
 $w > W$

根据这个确定 b 的取值后查表获得 a/b 和 w/b 的取值。

(我有点想根据 $Z_0 pprox rac{\eta_0}{4\left(rac{a}{b}-rac{2}{\pi}ln\left[sinh\left(rac{\pi g}{b}
ight)
ight]
ight)}$ 暴力求解,只需要确定 a/b 就能暴力反推出 g 和 w的值)

然后计算 f_c

TEM CELL的优缺点

优点

内部的测试不会受到周围物体和辐射的干扰

内部的强电场不会干扰周围的电子设备

限制

工作频率 $DC - f_c$

Example 1

PPT上的过程实在是太混沌了, 我尝试尽量计算出结果而不是查表

根据 H=0.25m 确定 $b_2=0.375m$,所以 b=0.75m

根据 w>W 判断出 a 至少要大于 0.5m

拍脑袋取 $\frac{a}{b}=1$

根据

$$Z_0pproxrac{\eta_0}{4\left(rac{a}{b}-rac{2}{\pi}ln\left[sinh\left(rac{\pi g}{b}
ight)
ight]
ight)}=50\Omega$$

解得 g=0.058m , 得到 w=0.634m 大于 W=0.5m 所以这个方案可行。



使用SOLVER求解

计算 f_c :

$$f_c = rac{150}{a} \sqrt{1 + rac{a/b}{\pi x \left(1 - x
ight) ln\left(rac{4a}{\pi g}
ight)}} = 241.67 \mathrm{MHz}$$

Example 2

数值计算,991能做,别怕

根据DUT高度 0.1m 确定 b=0.3m

根据 f_c 公式,把截止频率提高点免得翻车。

$$f_c = rac{150}{a} \sqrt{1 + rac{a/b}{\pi x \left(1 - x
ight) ln \left(rac{4a}{\pi g}
ight)}} = 450 MHz$$

解得

$$g = rac{4a}{\pi} e^{-rac{6a}{5\pi \left(9a^2-1
ight)}}$$

将 g 带回特征阻抗方程,解得

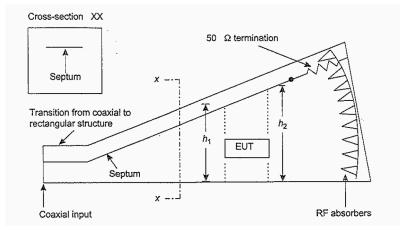
$$a = 0.34127m$$

从而获得

$$g = 0.029069m$$

GTEM CELL

这玩意是G赫兹TEM小室的简称,图长这样。隔板末端也是有50欧的负载,并且还需要贴有吸波材料防止反射。能够支持 $1\mathrm{GHz}$ 以上的频率。



GTEM CELL

GTEM CELL的优缺点

优点

工作频率可以从 DC 到数 GHz

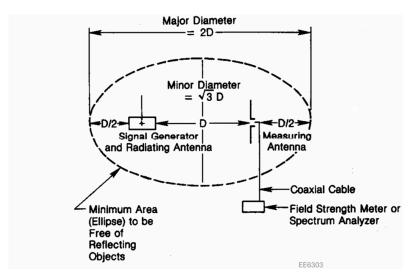
有屏蔽

缺点

对于大东西测试来说小了点

畁

OATS (Open Area Test Site)



OATS

测试的注意事项

周围不会有引发反射的物体 (一般在郊区)

需要一个导电的地平面

一般用3m法和10m法进行测试

优缺点

优点

建造和维护容易

缺点

会受到天气影响

环境电磁环境会影响发射的测量

高功率辐射测量可能会影响到周围的环境

由于环境噪声不同,测试结果不可复现

Shielded Enclosure

相关公式

Shielding Effectiveness

这玩意指的是入射波的强度和透射波的关系。这个值越高表示透射波衰减越厉害。

$$SE(dB) = R(dB) + A(dB) + B(dB)$$

其中 SE 指的是Shielding Effectiveness、 R 是入射波与吸波材料的反射损耗、 A 是吸波材料的吸收、 B 表示吸波材料与透射波交界面处的反射损耗。都是越大越好。

吸收系数A

复传播系数

$$\gamma = lpha + jeta = \sqrt{j\omega\mu\left(\sigma + j\omega\epsilon
ight)}$$

在复传播系数中,实部表示损耗,虚部表示相移。在这里我们主要考虑 α ,它表示波传播单位长度后振幅衰减 $e^{-\alpha}$.

所以我们可以得到

$$A\left(\mathrm{dB}
ight)=20log_{10}\left(e^{-ar}
ight)$$

为了从振幅转换成功率, log 前面的数字为20

对于理想导体和良导体有 $\sigma \ll \omega \epsilon$,可以取近似为 $\alpha \approx \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}}$,可以推出良导体中的吸收系数为:

$$A\left(\mathrm{dB}
ight)=20log_{10}\left(e^{-ar}
ight)=-20log_{10}e imes r\sqrt{rac{\omega\mu\sigma}{2}}$$

一些其他的变形:

用相对电导率替换电导率、频率替换角频率、材料厚度 t 替换传播距离 r:

$$A (dB) = -20 log_{10} e \times t \sqrt{\pi f \mu \sigma_c \sigma_r}$$

用趋肤深度 $\delta = \sqrt{rac{1}{\pi f \mu \sigma}}$ 替换:

$$A\left(\mathrm{dB}
ight)=-20log_{10}e imesrac{t}{\delta}$$

用相对磁导率和电导率替换(此处 t 的单位是 cm):

$$A (\mathrm{dB}) = 1.314 t \sqrt{f \mu_r \sigma_r}$$

(你是孔乙己吗整这么多没啥卵用的变形,草)

反射损耗

(总觉得这里有点问题, 老印多了个平方)

在垂直入射的情况下(非垂直入射的情况我推了一晚上推爆炸了,还不知道对不对,不写了),不同介质之间的关系可以用传输线进行建模,可得透射系数相对于阻抗的关系为:

$$T=rac{2\sqrt{\eta_1\eta_2}}{\eta_1+\eta_2}$$

其中 η_1 为入射波的特征阻抗, η_2 为透射波的特征阻抗。

其中透射波的阻抗可以用下式计算

$$\eta_2 = \sqrt{rac{j\omega\mu}{(\sigma+j\omega\epsilon)}}$$

假设入射波功率为 P_0 , 则透射波功率为 $P_0 imes T^2$

可以知道反射损耗为

$$ext{Reflection Loss} = 10log_{10}\left(P_0 - P_0 imes T^2
ight) = -10log_{10}T^2 = -10log_{10}\left(rac{4\eta_1\eta_2}{\left(\eta_1 + \eta_2
ight)^2}
ight)$$

老印的式子是: Reflection Loss $=-20log_{10}\left(rac{4\eta_1\eta_2}{(\eta_1+\eta_2)^2}
ight)$ 他写的有问题,正确的系数都是10。

对于金属屏蔽罩, $\omega\epsilon\ll\sigma$

可以得到

$$|\eta_2| = \left| \sqrt{rac{j\omega\mu}{(\sigma+j\omega\epsilon)}}
ight| pprox \sqrt{rac{\omega\mu}{\sigma}}$$

又由于 $\eta_1 \gg \eta_2$ 从而对反射损耗进行近似:

$$Rpprox -20(10?)log_{10}\left|rac{4\eta_2}{\eta_1}
ight|$$

材料对平面波的反射损耗:

入射波的特征阻抗为 120π 所以可以得到

$$R=-20(10?)log_{10}\left(rac{4\sqrt{rac{2\pi f\mu_0\mu_r}{\sigma_c\sigma_r}}}{120\pi}
ight)$$

其中 μ_0 为真空磁导率, σ_c 为铜的电导率。两个下标是 r 的是相对值。

材料对电场的反射损耗:

入射电场的特征阻抗

$$\eta_1=rac{\eta_0}{eta_0 r}$$

代入真空光速

$$c_0 = rac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$$

代入相位系数

$$eta_0 = rac{2\pi}{\lambda} = rac{\omega}{c_0}$$

可以得到

$$egin{align} \eta_1 &= rac{1}{\omega \epsilon_0 r} = rac{1}{2\pi f \epsilon_0 r} \ R &pprox -20(10?) log_{10} \left(8\pi f \epsilon_0 r \sqrt{rac{2\pi f \mu}{\sigma}}
ight) \end{aligned}$$

材料对磁场的反射损耗

类似地, 可以计算出入射磁场的特征阻抗:

$$\eta_1=\eta_0eta_0r=2\pi f\mu_0r$$

代入可以得到反射损耗约为:

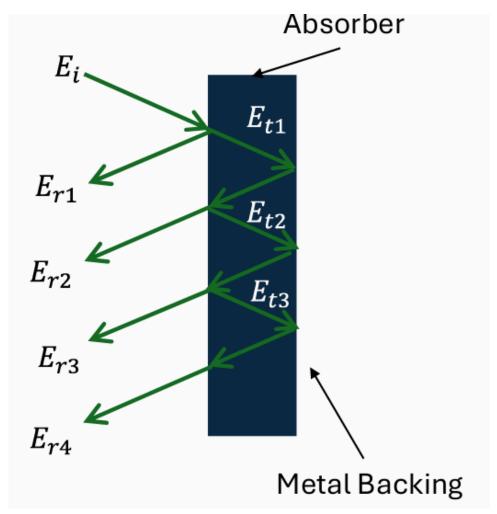
$$Rpprox -20(10?)log_{10}\left(rac{4\sqrt{rac{2\pi f\mu}{\sigma}}}{2\pi f\mu_0 r}
ight)$$

略

电波暗室的吸波材料

反射率是描述反射电场强度的指标

吸波材料的反射率是入射角、反射角的函数 (我前面在计算反射损耗的时候着重强调了**垂直入射**,就是因为这个)



吸波材料的反射特性

$$E_{ra} = E_{r1} + E_{r2} + E_{r3} + \dots$$
(1)

$$E_{r1} = E_i - E_{t1} \tag{2}$$

$$E_{r2} = E_{t1} \times A - E_{t2} \tag{3}$$

(这边老印想表达的是功率的关系吧,如果 E 表示的是电场的话还需要分别计算垂直和平行分量然后计算)

测量吸波材料的反射率

- 1、测量入射波到理想导电平面 (PEC) 的反射
- 2、计算反射电场强度和入射电场强度的比

$$rac{E_{r_{PEC}}}{E_{i}}$$

3、把吸波材料放到PEC上,测量反射场强并计算

$$\frac{E_{r_{Absort}}}{E_{i}}$$

4、反射率计算(你看这个公式就是功率的公式,说明确实是需要从功率方面考虑的,而不是前面的场强加减)

$$R = 20 log_{10} \left(rac{E_{r_{Absorb}}}{E_i} rac{E_i}{E_{r_{PEC}}}
ight)$$

5、重复不同的入射角计算

吸波材料的种类

Dielectric Absorber

轻

高介电损失(考虑复介电系数 $\epsilon=\epsilon'+j\epsilon''$ 对于复介电系数,实部的定义与一般的介电系数相同,虚部表示电流在介质中的损耗)

无磁性 $\mu_r = 1$

超宽带

厚

相关公式

波在高介电损失材料中的传播:

使用复传播系数解亥姆霍兹方程:

$$E\left(t\right)=E_{0}\left(t\right)e^{-\gamma z}$$

(我理解了很久,总算明白了PPT上这个公式里的t不是时间,而是厚度thickness......这里直接用正常的亥姆霍兹方程解了)

根据复传播系数定义 单位长度的衰减为 $e^{-\alpha}$

根据高介电损失材料的特性 $\mu=\mu_0$ 、 $\sigma=0$

可以得到:

$$lphapproxrac{\omega}{2}\sqrt{\mu_0\epsilon'}rac{\epsilon''}{\epsilon'}$$

定义介电损耗角正切为:

$$D = \frac{\epsilon''}{\epsilon'}$$

Example

(我超这也有啊)

题干条件:

相对介电系数: $\epsilon_r=2.55$

工作频率: 3GHz

损耗角正切: $D=rac{\epsilon''}{\epsilon'}=0.00033$

计算复传播系数的实部:

$$lphapproxrac{\omega}{2}\sqrt{\mu_0\epsilon'}rac{\epsilon''}{\epsilon''_{\prime\prime}}
onumber \ =\pi f\sqrt{\mu_0\epsilon_0\epsilon_r}rac{\epsilon''}{\epsilon'}
onumber \ =0.01657$$

如果厚度为 10cm

$$A = 20log_{10}e^{-\alpha z} = -0.0144$$
dB

真空磁导率: $\mu_0=4\pi imes10^{-7}$

真空介电常数: $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$

电波暗室使用的Dielectric Absorber的一些特性

被造成金字塔型

金字塔的高度决定了对不同频率的吸收率

反射率在30-50dB之间

工作频率:数百MHz到数GHz

Magnetic Absorber

使用含有磁性的材料 (铁氧体、碳、镍)

薄

有损耗 (不太理解, 没损耗还能叫吸波材料么)

窄带

在低频下工作良好

相关公式

仍然使用亥姆霍兹方程的解(真好用):

$$E\left(t\right) = E_0\left(t\right)e^{-\gamma z}$$

与复介电系数类似,复磁导率的虚部表示介质的损耗。

对于复磁导率

$$\mu=\mu'-j\mu''$$

可以计算得到复传播系数的实部:

$$lphapproxrac{\omega}{2}\sqrt{\epsilon_0\mu'}rac{\mu''}{\mu'}$$

同样地这里也存在磁场的损耗角正切

电波暗室使用的Magnetic Absorber一些特性

薄铁氧体陶瓷瓦片

频率范围30MHz-1GHz

能承受高温和高功率

非常重 (每平方米数十kg)

电波暗室的优缺点

优点

测试物的体积没有限制

可以测量数十Hz到40GHz甚至更高

支持电场、磁场和平面波测量

屏蔽效率大于100dB, 能支持高功率辐射测量, 低辐射泄漏

缺点

为了覆盖频率、照射角和极化方向需要的时间很长

如果要测量更大的物体和更长的测试距离, 需要更大的暗室

非常贵

Mode stirred chambers/reverberation chamber (模式搅拌室/电波混响室)

基本信息

腔室墙壁和搅拌器由高导电材料制成

搅拌器的旋转会改变腔体的边界条件

在不同的搅拌器位置,会出现不同的共振模式

腔室内生成的电磁场有如下特性:

振幅均匀

各个方向上各向同性

随机极化

测试的特点

抗干扰测试

测试对象将从所有方向和所有极化方式被均匀照射

不需要旋转测试对象

与在电波暗室中进行远场测试相比,产生共振所需的功率要少得多

没有方向性信息

发射测试

从所有方向接收测试对象的发射

不需要旋转测试对象

产生的共振使发射测试更加敏感

没有方向性信息

最低可用频率LUF

LUF是最低谐振频率的大约4倍

最低谐振频率的定义:

$$f_{mnp} = rac{c}{2}\sqrt{\left(rac{m}{a}
ight)^2 + \left(rac{n}{b}
ight)^2 + \left(rac{p}{h}
ight)^2}$$

其中 c 为真空光速, a 、 b 、 h 是这个房间的长宽高.

m 、 n 、 p 是正整数,表示电磁波在房间中的模式分布,最多有一个可以是 0

品质因数Q值

定义:

$$Q = \omega \frac{$$
最大储存的能量
平均能量损失

$$rac{1}{Q_{total}} = rac{1}{Q_1} + rac{1}{Q_2}$$

其中 Q_1 是墙壁导致的损失, Q_2 是天线的损失

$$Q_1 = rac{3V}{2\mu_r S\delta(\omega)}$$

其中 V 是内部体积, S 是内部墙壁表面积, $\delta(\omega)$ 是电磁波在导体的趋肤深度

$$Q_2 = rac{16\pi^2 V}{mN\lambda^3}$$

其中m是天线阻抗失配导致的损失,N是总天线数量

对于测量到的 Q 值, 定义如下:

$$Q=rac{16\pi^{2}V\left\langle P_{R}
ight
angle }{\lambda^{3}\left\langle P_{T}
ight
angle }$$

 $\langle P_R \rangle$ 和 $\langle P_T \rangle$ 分别是接收和发射功率的系统平均值

房间增益

定义为:

$$\langle G
angle = rac{\langle P_R
angle}{\langle P_T
angle}$$

测量到的电场

定义为:

$$\left\langle |E_T|^2
ight
angle = rac{8\pi}{\epsilon_0 c \lambda^2} \left\langle P_R
ight
angle = \left\langle |E_x|^2
ight
angle + \left\langle |E_y|^2
ight
angle + \left\langle |E_z|^2
ight
angle$$

Example

根据题意可以得到:

$$a = 1.136m$$

$$b=0.77m$$

$$h=0.535m$$

在 f_{011} 、 f_{101} 、 f_{110} 中找到最低的频率为 f_{110}

$$f_{110}=rac{c}{2}\sqrt{\left(rac{m}{a}
ight)^2+\left(rac{n}{b}
ight)^2+\left(rac{p}{h}
ight)^2}=235.339 \mathrm{MHz}$$

$$LUF = 4f_{110} = 941.351 \mathrm{MHz}$$